

# 精密先鋒：Athlete FA 領導日本製造業復興

Athlete FA 公司利用最先進的技術和對品質堅定不移的承諾，不斷開發半導體、電動汽車、電信和醫療領域的組裝設備。



「我們擁有精湛的技術……我們可以提供更高的價值，包括性能和品質。」

Athlete FA  
公司社長山崎 晋  
(Susumu Yamazaki)

Athlete FA 公司深耕於精密工程領域，秉持技術進步的精神，在日本製造業中佔據舉足輕重的地位。在公司社長山崎 晋 (Susumu Yamazaki) 的領導下，Athlete FA 公司在全球經濟和人口結構變遷的浪潮中傲然挺立，成為日本製造業卓越的燈塔。

山崎先生強調了公司對卓越技術和日本高標準的承諾：「我認為，Athlete FA 最大的武器是我們的卓越技術和日

本高標準。憑藉這些技術和品質武器，我們與世界上一些最大的公司開展業務往來。」

談及未來的發展前景時，山崎先生認為高級計算、數據中心和半導體行業是具備顯著增長潛力的領域，並補充說：「數據中心、伺服器 and 雲計算目前都在蓬勃發展。這三個行業未來都有望實現大幅增長。」

在進一步探討公司的產品組合時，山崎先生介紹了微型植球機 (BM-2150SI)：

「這套設備採用先進的印刷和植球技術，可實現直徑小至30微米的錫球陣列。在各種板尺寸、板厚度和板翹曲程度等條件下，它的完美性能受到了全球用戶的一致好評。」

談到量產倒裝晶片接合器 (CB-3000)時，山崎先生詳細說明了它的校準功能：

「內置一種機制可以對默認設置進行自我調整和微調，實現糾正錯誤並提供最佳性能。為了達到這一目標，這套設備在每一個步驟都要經過審查、驗證和檢查，最終實現最高的速度和精度。」

公司社長還提到使用高精度晶片接合器 (AB-1000) 支持八英寸和十二英寸晶圓的

重要性。他解釋說：「該設備的性能超出了預期，基板側的最大晶粒尺寸為2.5毫米，可裝載晶片尺寸最小可達0.50毫米至1毫米。」



CB-3000 C4  
工藝能力倒裝晶片接合器

Athlete FA 公司的收入增長顯著，自2020年以來，公司銷售額以每年50%的速度增長。展望未來，山崎先生概述了維持和加速收入增長的戰略，重點是產品創新和增強能力，以滿足不斷變化的需求。

社長先生還分享了公司在增長軌跡方面的成績和預期：「過去三年，由於新冠疫情的原因，半導體、伺服器和PC的需求激增，令我們驚喜不已的是，我們的業績隨之翻了一番。為了滿足這些高漲的需求，我們不得不與外部供應商合作，以應對雙倍的工作量。然而，半導體行業目前正處於暫時的停滯期。但我們預計這種情況將在2025年後有所恢復。我們強調持續改進和創新，以滿足客戶未來不斷變化的需求。其中的一個例子是，我們正在開發兼容亞微米級的設備。隨著這些產品的開發，我們的銷售額將會實現增長。」

在業務擴張方面，山崎先生表示將重點放在擴展海

外業務，尤其是東南亞。他說：「在海外，我們主要在台灣和中國以及韓國開展業務。然而，我們也在加強歐洲、美國和東南亞的銷售。此外，我們還看好印度等新興國家，但目前我們對這些國家仍知之甚少。專家預測，這些新興國家將實現大幅增長，這意味著那裡的需求遲早都會出現。老實說，我們希望在任何有潛力的國家都進行擴張。」

談到未來的合作夥伴關係，山崎先生補充道：「目前，我們有20%的客戶來自國內，80%來自海外。這意味著我們的海外業務正在不斷增長。隨著Athlete FA繼續與分銷商開展合作，我們將繼續加強公司的合作夥伴關係。」

憑藉清晰的願景、創新的精神和對品質堅定不移的承諾，Athlete FA 公司將持續在日本製造業蓬勃發展的潮流中開闢一條成功之路。公司已經整裝待發，準備迎接未來的挑戰和機遇，在這過程中有一點是肯定的——追求卓越的精神將持續推動公司的發展，並在全球舞台上產生舉足輕重的影響。



AB-1000  
高精度晶片接合器



BM-2150SI  
微型植球機

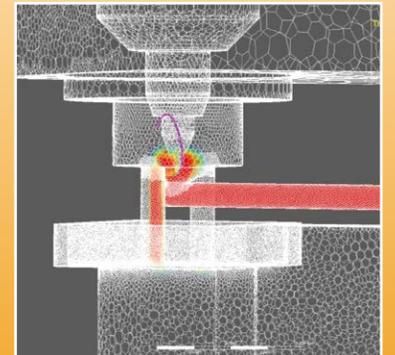
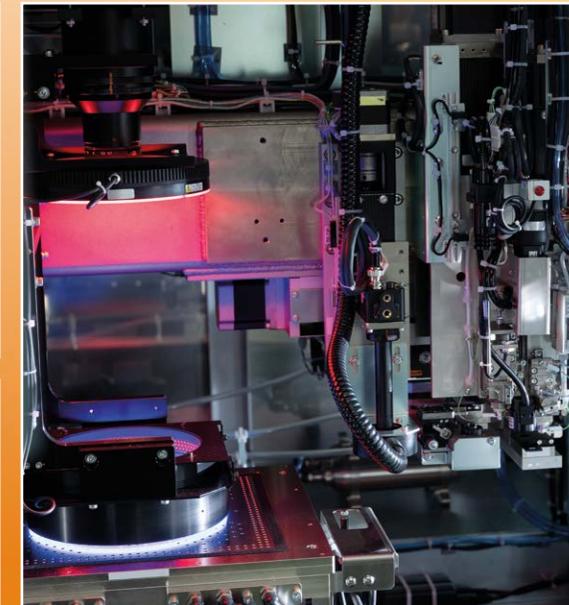
# Athlete

## Create Future Arts

The Athlete brand expresses our commitment to craftsmanship and endless challenges in semiconductor back-end processes [www.athlete-fa.jp/en](http://www.athlete-fa.jp/en)



Advance Accuracy Assembly leading technology



Suwa, Nagano, Japan